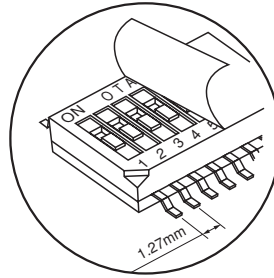


特 長

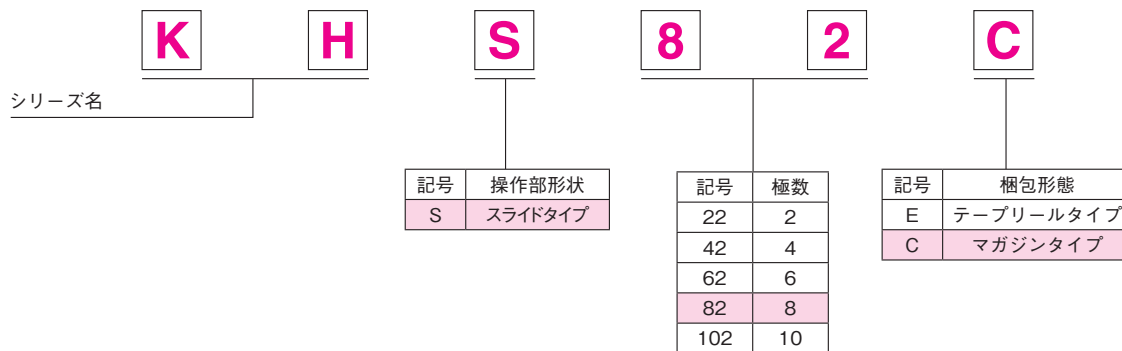
1. 内部機構の極超小型化により、ハーフピッチ (P = 1.27mm) の極超小型化を実現。
2. 高密度実装可能 (当社比 8 極にて面積 41.9%)
3. 接点は、金メッキ標準仕様。
4. SMT マウンターによる自動実装、リフロー及び洗浄 (テープシールによる) 可能。
自動実装に関してはテープリール、マガジン等の対応可能。

主な仕様

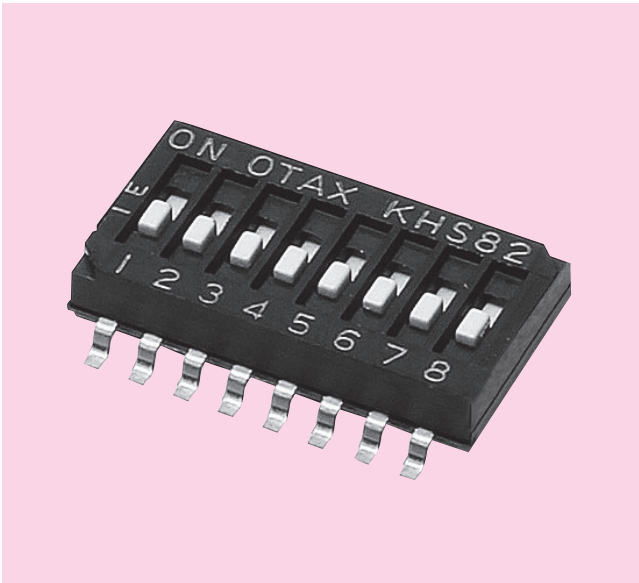
定格	DC24V 25mA
接触抵抗	100mΩ以下
絶縁耐圧	AC300V 1分間
絶縁抵抗	100MΩ以上
電氣的寿命	1000回
使用温度範囲	-30 ~ +85°C
保存温度範囲	-30 ~ +85°C
動作力	4.9N MAX
リフロー回数	2回



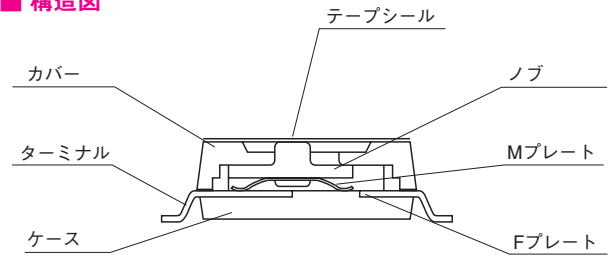
品名の呼称



※上記商品以外・カスタム品についてはお問合せください。



■ 構造図

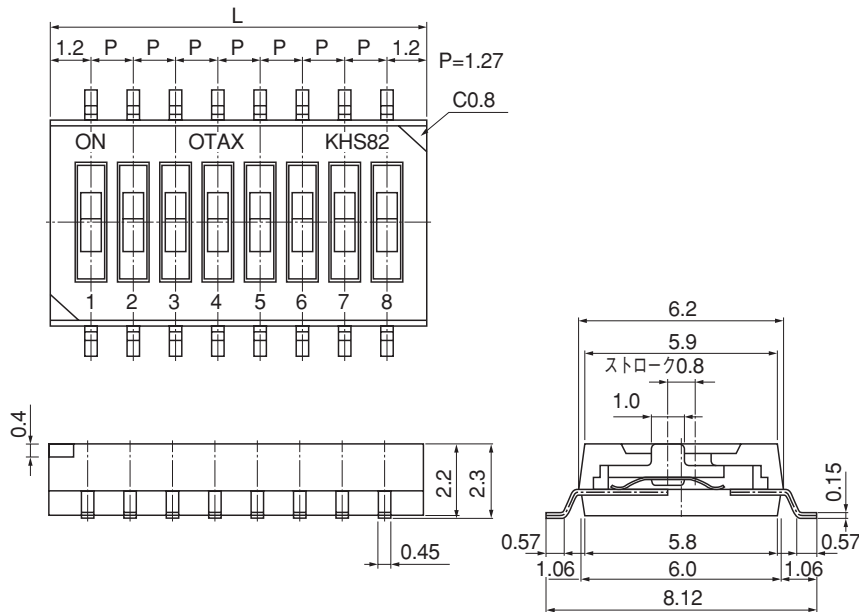


材料仕様

部品名	材質	仕上
カバー	PPS	黒色
ノブ	液晶ポリマー	白色
ケース	PPS	黒色
ターミナル	銅合金	金フラッシュ
Fプレート	銅合金	金メッキ
Mプレート	銅合金	金メッキ

標準寸法

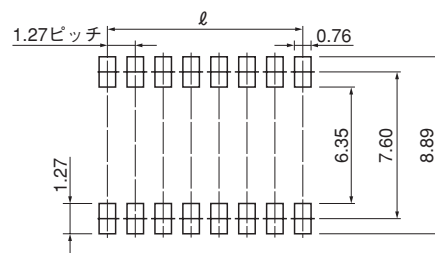
KHS□□



品名及び寸法

品名	極数	L(mm)	ℓ(mm)
KHS22□	2	3.67	1.27
KHS42□	4	6.21	3.81
KHS62□	6	8.75	6.35
KHS82□	8	11.29	8.89
KHS102□	10	13.83	11.43

取付ランド寸法

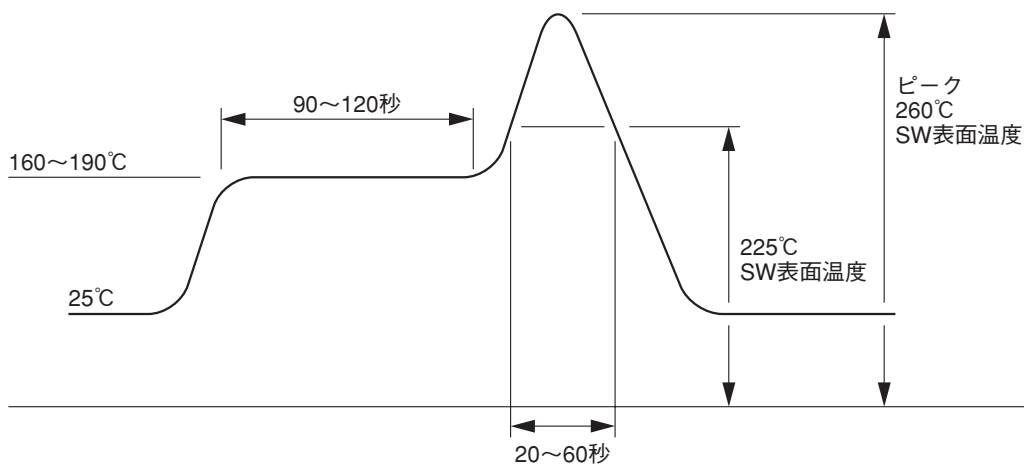


半田付について

●半田付条件

手半田	コテ先温度 320℃以下 4 ± 1 秒
リフロー半田 (面実装)	プレヒート 160 ~ 190℃ 90 ~ 120 秒 リフロー温度 225℃ 20 ~ 60 秒 ピーク 260℃以下

●半田リフロー条件



製品取扱上の注意

1. 洗浄液は、アルコール類、石油系、ケトン系、塩素系溶剤が使用できます。但し、テルベン系洗浄剤を御使用の場合は、前もってお問い合わせ又は、御確認の上、御使用願います。
2. リフロー半田には実際の作業工程に於いて P/C ボードの寸法、組立密度に依って異なりますので、代理店、又は直接当社にお問い合わせ下さい。

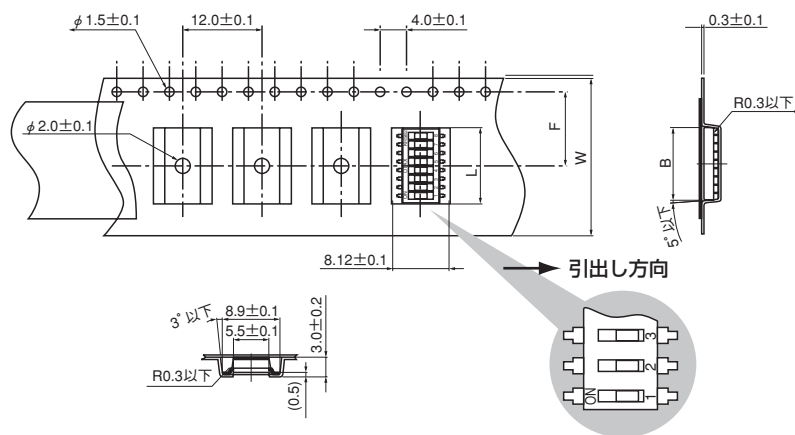
梱包箱・マガジン梱包数量

極数	マガジン1本 当たりの個数	一箱梱包数量
2	125個	12,500個
4	70個	7,000個
6	50個	5,000個
8	40個	4,000個
10	30個	3,000個

※ 1 箱当たりのマガジン本数は 100 本です。

■テープリールパッケージは 2,000 個です。

テープリールパッケージについて



極数	W	F	B	L
2P	16.0±0.3	7.5±0.1	4.45±0.1	3.67±0.5
4P			7.0±0.1	6.21±0.5
6P			9.55±0.1	8.75±0.5
8P	24.0±0.3	11.5±0.1	12.1±0.1	11.29±0.5
10P			14.6±0.1	13.83±0.5

適用規格

JIS C 0806
 TB0804 ~ TB2420
 EIA-481-A
 16,24mm Embossed Tape